

并购重组进行时

今年以来截至3月23日，A股市场已有56家上市公司披露了半导体业务并购的相关公告

“快鱼吃慢鱼”助力半导体行业创新发展

■本报记者 张敏 陈红

2025年以来，半导体行业的并购重组持续火热，众多上市公司试图借助并购重组优化企业战略布局，推动业务拓展升级，也有望促进整个行业的高质量发展。

对此，多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示，这标志着我国硬科技投资正在步入新阶段。随着半导体产业的逐步成熟，宏观环境的演变以及投资机构能力的持续增强，我国半导体行业系统性并购重组的黄金时代已然开启，行业正从零散的机会探索向纵深的战略协同加速转变。

并购案例频出

今年以来，半导体行业并购案例频出。据《证券日报》记者不完全统计，截至3月23日，A股市场已有56家上市公司披露了半导体业务并购的相关公告。其中，32家为半导体材料与设备、产品上市公司，也有来自制药、环保、机械、化工等非半导体行业的上市公司，拟跨界并购半导体业务标的。

以半导体行业龙头企业、总市值超2000亿元的北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”)为例，公司计划“两步走”获取市值200亿元的沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”)控制权，这是今年以来，A股半导体行业第一起“A吃A”案例。若交易达成，北方华创在刻蚀、薄膜沉积的优势，能与芯源微涂胶显影业务形成互补，大幅提升企业在集成电路装备领域的协同效应与市场竞争力。

部分上市公司更是开启了连续并购模式。3月4日，TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)披露公告称，公司计划斥资115.62亿元，购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.53%股权。此前，TCL科技还宣布斥资108亿元收购乐金显示相关公司股权，3月19日，该公司股权工商变更完成。

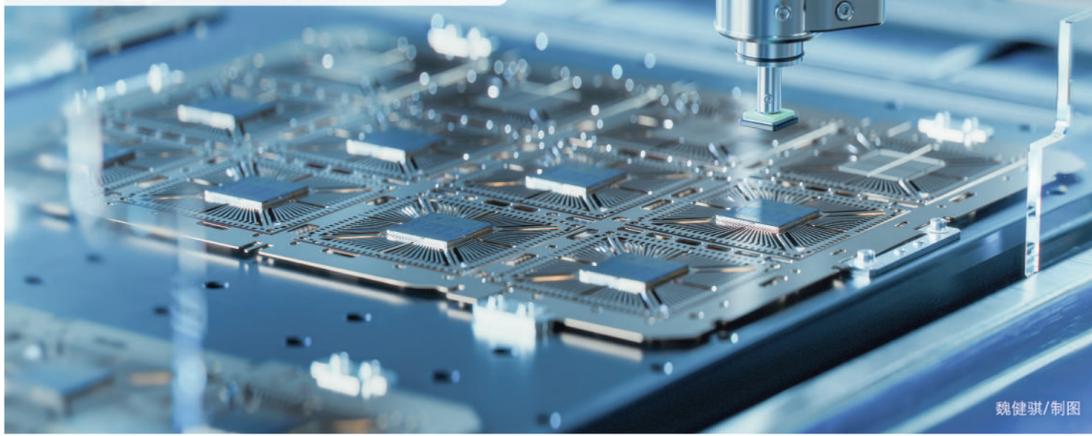
此外，半导体上市公司发布重组事件的频率也显著增加。仅在3月10日至3月16日期间，A股市场就有包括北方华创、上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”)、扬州扬杰电子科技股份有限公司、江苏海海诚科新材料股份有限公司(以下简称“海海诚科”)在内的4家半导体上市公司发布了并购资产相关公告。

对于行业并购案例数量的快速增长，元禾璞华(苏州)投资管理有限公司合伙人牛俊岭向《证券日报》记者表示，半导体行业具有资金密集、技术密集、行业周期性强等特点，并购重组能够实现资源整合、技术互补，产生协同效应，成为企业突破发展瓶颈的关键手段。

半导体产业链条较长、细分领域繁杂，存在众多小而美的“单

据《证券日报》记者梳理

在A股半导体公司的并购标的中，设计、材料和封装领域的标的占比较高



魏健琪/制图

项冠军”企业，但这类企业成长的天花板往往较低，想要扩展产品品类和市场，横向并购是很理想的途径，能够快速获取产品、技术和市场。

“对于行业巨头而言，供应链的稳定与安全至关重要，垂直整合不仅有助于提升技术储备，还能优化成本，因此沿产业链的纵向并购也屡见不鲜。”牛俊岭表示，半导体行业技术更新迭代极为迅速，上市公司唯有通过“快鱼吃慢鱼”，才能快速获取先进技术、专利和人才团队，有效缩短研发周期。

打通关键环节

《证券日报》记者梳理发现，在A股公司的并购标的中，半导体设计、材料和封装领域的企业占比较高，这三大领域正是我国半导体产业实现升级发展的关键环节。

半导体设计环节主要涵盖芯片设计与电子设计自动化(EDA)两大领域。在芯片设计板块，新相微收购深圳市爱协生科技股份有限公司控制权，旨在丰富公司显示触控一体驱动芯片、触控驱动芯片等产品线，储备相关技术，拓展产品应用场景。

牛俊岭认为，模拟芯片是国内芯片设计领域上市公司数量最多的赛道，市场竞争也较为激烈，国内企业通过并购能快速弥补技术短板，扩充产品线，朝着平台型企业的方向发展。

EDA作为集成电路设计的核心工具，素有“芯片之母”之称，其技术贯穿芯片设计、验证、制造等全流程，是半导体产业链的底层支撑。目前，全球EDA市场主要由海外巨头主导，国产EDA工具仅覆盖了部分设计流程。近期，这一领域的并购活动也有所增多。如3月17日，国内EDA龙头企业北京华大九天科

技股份有限公司宣布，公司拟收购芯和半导体科技(上海)股份有限公司股权，后者是一家专注于EDA软件工具研发的高新技术企业。

半导体材料是制作各类半导体器件的关键，种类丰富，市场整体已被海外厂商把控，国内企业布局大多集中在单一环节或产品，需要通过并购拓展赛道。如上海硅产业集团股份有限公司拟收购旗下三家半导体子公司股权，全资控制300mm(12英寸)大硅片核心资产。

封装测试是半导体产业的后端环节，对芯片性能和可靠性有着重大影响。目前，国内封装技术已接近国际水平，但设备与材料配套能力相对薄弱，并购成为企业快速补强产业链的关键手段。如通富微电子股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、海海诚科等公司纷纷开展了对这一领域的并购工作。

华海诚科工作人员向《证券日报》记者表示：“公司拟收购衡所华威电子有限公司70%股权，主要是看好先进封装环氧塑封料领域的发展前景，为此深度整合先进封装技术资源与客户资源，快速布局契合未来趋势的主流芯片封装材料。”

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《证券日报》表示，半导体领域并购热潮是企业主动作为与行业加速整合的必然结果，将对关联科技领域产生深远影响，推动科技产业生态朝着更具创新性和协同性的方向发展。

资源整合是关键

尽管半导体行业并购热度高涨，但能否成功还需历经多重考验。3月18日，深圳英集芯科技股份有限公司宣布放弃收购辉芒微电子(深圳)股份有限公司；3月4日，深圳市汇顶科技股份有限公司

也宣布终止收购云英谷科技股份有限公司。两家上市公司终止收购的理由，均是因交易对价等条款未达成一致。

《证券日报》记者致电上述两家公司时，工作人员均表示，目前公司生产经营情况正常，本次交易的终止不会对公司的经营产生重大影响。

中国金融智库特邀研究员余丰慧向《证券日报》记者表示，上述两起终止收购案例，凸显了并购市场上上市公司对于标的公司估值的谨慎态度，也为其他企业在进行并购交易时提供了估值参考，促使各方更加理性地对待并购标的的价值评估。

除半导体领域内的上市公司积极参与并购以外，也有部分上市公司宣布跨界并购半导体公司，谋求转型发展。去年，海南双成药业股份有限公司宣布跨界重组，拟购买宁波奥拉半导体股份有限公司的100%股权，但在今年3月11日，公司宣布终止该收购计划，原因是各交易对方取得奥拉股份股权的时间和成本差异较大，交易各方对本次交易的预期存在分歧。

在牛俊岭看来，半导体行业并购最大的挑战是资源整合效率与效果。企业后续能否实现高效的资源整合，如拓展渠道、技术互补、产业升级、提升盈利能力等，才是衡量其并购重组成败的关键指标。

安永大中华区审计服务市场联席主管合伙人汤哲辉向《证券日报》记者表示，这需要上市公司建立健全内部控制体系，提升管理水平，保障并购及整合的顺利推进，避免出现“无效沟通”“貌合神离”的情况。

热潮有望延续

据多位业内人士预计，在市场需求回暖、政策引导以及创新升级的多重驱动下，半导体行业

并购将持续升温。

另据中研普华产业研究院预计，2025年全球半导体市场规模在6000亿美元至7000亿美元之间，同比增长率约为10%至15%。

汤哲辉认为，半导体行业的发展驱动因素已从“消费端”转变为“消费+企业端”。过去，智能手机等智能硬件兴起，使得消费端成为半导体行业发展的核心驱动力。如今，智能汽车、机器人、云计算、人工智能等企业端场景需求渐长，各行业加速数字化转型，这一趋势正在促使产品需求和应用发生变化，低端消费电子、TV面板等弱应用被淘汰，汽车、机器人、云计算等强需求领域成为了半导体行业新方向。

在政策引导方面，上海、北京、无锡等地纷纷发文支持并购重组。例如，3月17日，《苏州市加快发展AI芯片产业的若干措施(征求意见稿)》对外发布。其中提到，推动AI芯片企业通过兼并重组等方式提升资源整合能力，向产业链上下游布局拓展业务。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日报》记者表示：“这些政策为半导体企业营造了有利的政策环境，降低了企业并购重组的成本和风险，有助于企业间进行资源整合与协同发展，进而实现强强互补，推动半导体产业向产业链上下游拓展，提升产业在全球范围内的竞争力。”

复盘全球半导体产业历程，欧美巨头靠果敢精准的并购整合实现了飞跃，筑起行业壁垒。中国半导体产业历经长期深耕，在部分领域已崭露头角，但对比海外仍有差距。当下，我国半导体行业，正以优势企业为核心，整合资源，形成发展协同，加快推动产业全球竞争力的不断提高，实现从产业大国到强国的跃升。

266家A股公司
拟分红合计超2000亿元

■本报记者 桂小笋 李亚男

近日，随着A股公司2024年年度报告披露数量的快速增长，上市公司现金分红方案日益受到市场关注，一些“豪横”的分红方案一度成为市场关注的焦点。

同花顺数据显示，截至3月25日，已有266家公司拟推出年度现金分红方案，按对应的股本计算，分红总金额已超过2000亿元。

接受《证券日报》记者采访的行业人士表示，上市公司回报投资者意愿提升，持续加大现金分红比例和频次，对于稳定市场预期，吸引价值投资者有明显助益。

同花顺数据显示，在上述266家公司中，有21家公司每股拟分红金额超过1元(含税)。

例如，宁德时代新能源科技股份有限公司在2024年年报中提及，拟向全体股东每10股派发现金红利45.53元(含税)。公司同时发布公告称，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。

记者通过梳理相关公告发现，除了年度分红之外，特别派发红利也常有出现。例如，无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“药明康德”)拟向全体股东每10股派发现金红利9.8169元(含税)，以目前公司总股本测算，共计派发现金红利28.35亿元(含税)。同时，药明康德还发布了2025年回报股东特别分红方案，公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，以公司总股本测算，共计派发现金红利约10.11亿元(含税)。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，分红频次增加反映出企业正在从“融资导向”转向“回报股东导向”，是市场健康发展的重要标志。分红是价值型投资者持有股票的核心收益来源之一，稳定且持续的分红能够传递公司盈利能力和现金流充足的信号。

从分红占当期净利润比例来看，有一些公司的分红堪称“豪横”。例如，中国神华能源股份有限公司披露公告称，拟向全体股东派发2024年度末期股息每股2.26元(含税)，拟派发现金红利金额约为449.03亿元(含税)，占2024年度中国企业会计准则下归属于公司股东净利润的76.5%。

上海明伦律师事务所王智斌律师向《证券日报》记者表示，在新“国九条”推出之后，中国证监会、交易所等都推出了系列配套措施，鼓励上市公司加大分红力度。同时，上市公司也积极发布公告，对回报投资者计划进行了披露，随后，中期分红、季度分红、年度分红的企业数量和分红力度都较以往明显增加，这有助于吸引长期资金，增强投资者获得感。

在詹军豪看来，对于投资者而言，建议关注上市公司分红的持续性、股息率合理性等指标。分红政策是评估公司治理质量和投资价值的重要维度，但也要结合公司的成长潜力、财务健康度等多因素综合分析公司的投资价值。

15家A股公司
披露一季度业绩预告

■本报记者 桂小笋 李亚男

同花顺数据显示，截至3月25日记者发稿，A股市场已有15家公司率先披露了2025年第一季度业绩预告。其中，有12家公司预计报告期末净利润实现不同程度增长。从所属行业来看，12家公司中有5家来自于计算机、通信和其他电子设备制造业(按证监会行业分类)。

深圳市前海排排网基金销售有限公司研究部副总监刘华在接受《证券日报》记者采访时表示，今年以来，全球AI算力需求持续快速增长，上述板块直接享受到了AI基础设施迅速扩张带来的红利。与此同时，政策对相关产业发展的大力支持，也推动了相关公司的业绩增长。

从业绩预告同比增长幅度(按预告净利润同比变动最大幅度排序，下同)来看，胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”)预计今年第一季度净利润同比增长幅度最高，达367.54%。

胜宏科技在公告中表示，公司坚定“拥抱AI，奔向未来”，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。

北京止于至善投资管理有限公司基金经理何理向《证券日报》记者表示，从需求端来看，5G网络、人工智能、云计算等需求加速释放，叠加消费政策支持背景下，消费电子市场回暖。从经济大环境来看，全球经济复苏预期下，企业备货积极性增强，电子元器件和大宗商品成本压力缓解，共同助力了上述领域在第一季度实现盈利增长。

在何理看来，AI算力对上市公司业绩的积极影响主要体现在业务增长、产业链协同、降本增效及产品升级四个维度。短期来看，随着全球AI算力投资爆发，硬件供应商(如芯片、服务器、光模块企业)和云计算服务商将优先受益于需求激增，业绩增长具备较高确定性。从中长期来看，AI算法迭代与应用场景扩展情况更值得关注。

在业界看来，AI时代，算力基础设施完备度、数据治理理能力、算法迭代速度及场景落地能力将成为衡量企业竞争力的新标准。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”)预计今年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长44.29%至60.32%。而业绩变化的原因，道通科技披露，系报告期公司继续大力推进“全面拥抱AI”战略，加速推动AI技术与业务场景的深度融合。AI赋能数智维修产品和数智能源产品及方案，不仅提高了公司产品及方案的竞争力与盈利能力，还逐步提高了市场占有率和影响力。

刘华认为，随着AI技术持续深入到各行各业，企业的竞争力评价体系正在发生改变，“AI能力”正在成为新的核心竞争力。

“企业要保持AI技术的前瞻性，还需多维度布局。”何理建议，在技术层面，加大核心算法、芯片架构等底层研发投入，并通过产学研合作跟踪前沿技术，如量子计算等。在应用层面，聚焦垂直领域应用，构建“行业知识+AI模型”的差异化壁垒。在战略层面，建立动态技术评估机制，平衡短期商业化与长期技术储备。

A股公司海外并购持续升温

■本报记者 冯思捷

A股上市公司海外并购的热情仍然不减。据《证券日报》记者不完全统计，3月份以来，已有至少5家公司首次披露了海外并购计划。

3月11日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“万丰奥威”)发布公告称，公司下属子公司heptus 591.GmbH与Volocopter GmbH管理人Tobias Wahl签署了《资产收购协议》，heptus 591.GmbH拟收购Volocopter GmbH名下相关有形资产、知识产权及承接特定合同权利义务。

万丰奥威表示，公司本次收购Volocopter GmbH名下相关有形资产、知识产权等，可以加速推进公司低空领域的全球开发应用进程，

在本次收购相关资产的基础上，开发先进的eVTOL产品，打造公司全新业务增长新引擎。

3月7日，中路股份有限公司(以下简称“中路股份”)披露公告称，公司控制的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过其全资子公司中路优势全球投资有限公司使用自有资金与厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业(有限合伙)指定的全资子公司VSI Cycling Limited境外收购及增资方式持有境外公司Factor Bikes Pty Ltd(以下简称“Factor”)52.87%股权，各方分别以1526.39万美元、2289.58万美元持有标的公司21.15%与31.72%股权。

资料显示，Factor是英国高端自行车品牌，拥有成熟的研发

创新产品设计及工程制造能力。中路股份期望通过后续的合作，形成自主研发国际顶级碳纤维自行车的技术能力，以此推进高端碳纤维自行车品类的市场开拓，促进永久品牌高端车型出海。

此外，苏州欧圣电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司、惠州光弘科技股份有限公司等，都在3月份披露了海外并购相关计划。

事实上，当前跨境并购，既有政策层面的战略引导，也有市场主体的主动求变。

2024年9月份出台的“并购六条”明确，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。这一政策信号极大地提振了企业

参与并购的信心。

与此同时，我国诸多产业正面临从“制造”向“智造”跃升的关键期。并购，尤其是对海外先进资产的并购，正成为国内企业实现“弯道超车”的重要途径之一。政策赋能与内生需求形成共振，推动企业将跨境并购作为打开增长新局的突破口。

努曼陀罗商业战略咨询公司创始人霍虹虹认为，跨境并购的最大优势是“用时间换市场、用资本买能力”。“海外并购的协同效应通常体现在以下三方面：一是技术协同，如万丰奥威收购Volocopter资产，不仅是获取硬资产，更是通过技术、专利、团队的整合，快速打通低空经济的产业链闭环；二是品牌和

这一高端自行车品牌，直接获得欧洲成熟的销售网络与消费认知，为其国产品牌出海打通通路；三是产品能力升级，海外研发+国内制造，形成“前沿创新+成本效率”的组合拳，构建增长引擎。”霍虹虹向《证券日报》记者表示。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元表示，从战略层面来看，随着国内市场竞争加剧，企业希望通过拓展海外市场来扩大市场份额，寻找新的增长空间。